

TessolveとNXPの協業によるデジタル・コネクテッド・クラスターの製品化を可能にします

東京、東京、日本、2024年5月29日
TessolveとNXPの協業によるデジタル・コネクテッド・クラスターの製品化を可能にします(DCC)に関するお知らせ

TOKYO, TOKYO, JAPAN, May 29, 2024
/EINPresswire.com/ --

TessolveとNXPの協業によるデジタル・コネクテッド・クラスターの製品化を可能にします。NXPのi.MX RT1170 MCUとAW611 Wi-Fi/Bluetooth KW45 Bluetooth LE MCUとPF5103 PMI CEM

は、二輪車の大衆市場向けデジタル・コネクテッド・クラスターの製品化を可能にします。Tessolve

は、二輪車の大衆市場向けデジタル・コネクテッド・クラスターの製品化を可能にします。OEM

NXP i.MX RT1170とSMARC



「TessolveとNXPの協業によるデジタル・コネクテッド・クラスターの製品化を可能にします。NXPのi.MX RT1170 MCUとAW611 Wi-Fi/Bluetooth KW45 Bluetooth LE MCUとPF5103 PMI CEM

*Kiran Kumar
Nagendra, AVP-
Embedded Systems*



TESSOLVE
A HERO ELECTRONIX VENTURE

と NXP

は、二輪車の大衆市場向けデジタル・コネクテッド・クラスターの製品化を可能にします

SoM Tessolveの協業によるデジタル・コネクテッド・クラスターの製品化を可能にします。2023年3月5日(7000)BLE Wi-Fi 6 NXPの協業によるデジタル・コネクテッド・クラスターの製品化を可能にします。CAN

NXPの協業によるデジタル・コネクテッド・クラスターの製品化を可能にします。E V) NXPの協業によるデジタル・コネクテッド・クラスターの製品化を可能にします。

